



Automatic Surface Grinder

DAG810

适合新型加工需要的自动研削

结构精炼的单轴自动研削机

最大可加工 $\phi 8$ 英寸工作物的单轴，单工作台小型自动研削机。

占地面积仅为1.02 m²的简洁设计

设备尺寸为600 (W) × 1,700 (D) × 1,780 (H) mm。

占地面积只有1.02 m²。

可保证高精度研削的机械结构及研削方式

通过采用新开发的高刚性，低振动主轴，保证了高精度的研削加工质量。研削方式有纵向切入式研削和横向蠕动式研削（作为特殊选配）。

适用于研削多种材料

除了硅（矽）晶圆外，还可加工多种硬脆材料和电子组件。



操作简便

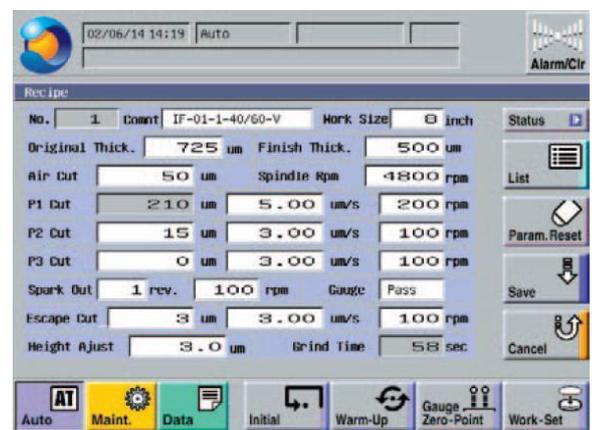
DAG810配置了触摸式液晶显示器及图形化用户接口GUI（Graphical User Interface），提高了操作便利性。而且设备的机械状态和加工状况可在控制画面上同步显示，操作人员通过触摸控制画面上的按钮，可以简单地完成操作。

可满足多种加工要求（选配）

- 可装配单探针式高度计或双探针式高度计（特殊选项）
- 纵向切入式研削，最大加工直径可扩大到 $\phi 300$ mm（特殊选项）
- 加工带切割框架的晶圆时，加工直径可达 $\phi 8$ 英寸（特殊选项）
- 横向蠕动式研磨，最大加工直径可扩大到 $\phi 200$ mm（特殊规格）

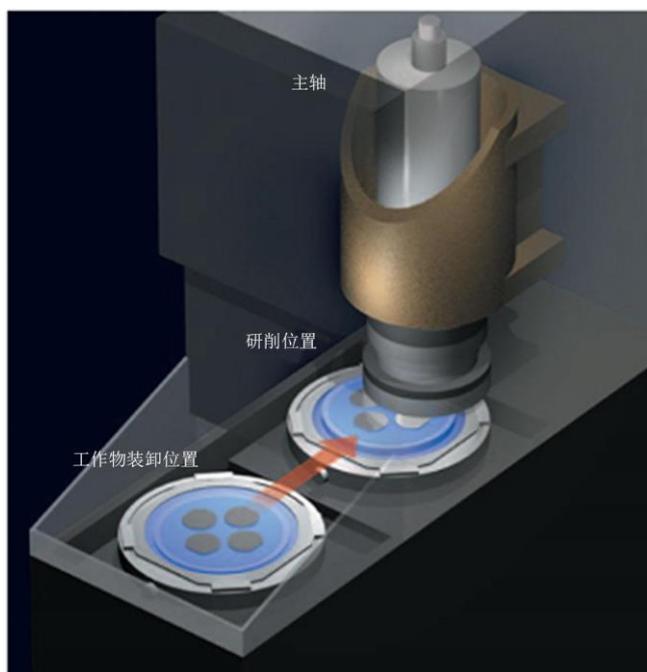
高精度加工应用实例

- 可用于硅（矽）晶圆，半导体化合物等的研削分析
- 可用于CSP / WL-CSP的树脂研削及铜电极露出加工
- 用于提高LT / LN等的平面度
- 还可加工未烧结陶瓷、蓝宝石（小直径）等



操作画面

Automatic Surface Grinder DAG810



*带框架的研磨需要使用专用的夹具（选配）

Specifications			
Specification	Unit		
Wafer Diameter	mm	φ 200 (φ 4"/5"/6"/8" with universal chuck table use)	
Grinding Method	-	Anomalous In-feed grinding with wafer rotation	
Grinding Wheels	mm	Φ200 Diamond Wheel	
Spindle	Output	kW	4.2
	Rated torque	N·m	5.9
	Revolution speed range	min ⁻¹	1,000 - 7,000
Machine dimensions(W×D×H)	mm	600 × 1,700 × 1,780	
Machine weight	kg	Approx.1,300	

■ 使用条件

- 请使用大气压露点在-15℃以下，残余油分为0.1 ppm，过滤度在0.01 μm/99.5%以上的清洁压缩空气。
- 请将放置机械设备的房间室温设定在20℃~25℃之间，并将波动范围控制在±1℃以内。
- 请将切削水的水温控制为室温+0~2℃（波动范围在±1℃以内），将冷却水的水温控制为与室温相同（波动范围在±1℃以内）。
- 其它，请避免设备受到撞击及外界的可感振动。另外，请不要将设备安装在鼓风机、通风口、产生高温的装置及产生油雾的装置附近。
- 本设备会使用水。万一发生漏水影响，请把本设备安装在有防水性的地板及有排水处理的场所。
- ※ 为了改进设备，本公司可能在预先不通知用户的情况下，就对本规格实施变更，因此请仔细确认规格后发出订单。
- ※ 压力全部使用压力表指示压力值表示。
- ※ 关于本设备的应用技术等咨询，请与本公司销售部门联络。
- ※ 如需使用纯水以外的研磨液，请向本公司销售担当咨询